

2007年8月2日

電子部品実装機（チップマウンタ）の新工場を建設

- 埼玉県妻沼西部工業団地内に建設、生産能力を増強 -

株式会社日立ハイテクノロジーズ（執行役社長：大林 秀仁 / 以下、日立ハイテク）の100%子会社である株式会社日立ハイテクインスツルメンツ（群馬県邑楽郡大泉町、社長：生見 益三）は、電子部品実装機（チップマウンタ）の生産能力増強を図るため、埼玉県熊谷市に新工場を建設します。

新工場は、2007年8月から建設を着工し、2008年2月に竣工予定です。敷地面積は約32,500㎡で、土地の取得費用も含めた総投資額は約35億円です。

携帯電話やデジタルカメラ、液晶・プラズマテレビなどのデジタル家電は、高機能・多機能化と同時に、小型・軽量・薄型化が要求されています。デジタル家電メーカーは、変化の激しい市場動向に対応したフレキシブルな生産体制を整えることが必須となっており、電子部品実装機には高精度化、生産性向上が求められています。また、国内での地上波デジタル放送の開始、北京オリンピックなどの影響により、日本国内だけでなくアジア、欧米でのデジタル家電製品の需要拡大が見込まれており、高速・高性能な電子部品実装機の需要が高まっています。

日立ハイテクインスツルメンツは、電子部品実装機の高効率生産、開発スピードの迅速化、品質・サービスの向上を図るため、現在の工場（群馬県大泉町）を埼玉県熊谷市に移転し、新工場を建設します。新工場は、鉄骨2階建て、幅122m、奥行き70m、建屋高さ15mで、延べ床面積は17,500㎡となります。生産スペースを現在の約2倍に拡大することにより、部品受入から出荷までの一貫生産ラインを築くことで、生産効率の向上を図ります。

また、新工場内にグループ会社である株式会社日立ハイテクエンジニアリングサービスのサービス機能も集約し、連携を図ることで、開発スピードを迅速化し、品質保証・サービス体制を強化します。同時に、設計から製造まで含めた生産方式の改革を実施し、2010年度までに年間1,200台の生産体制を構築する予定です。

日立ハイテクは、今回の新工場建設のほか、海外サービス拠点の拡充、サービス員の育成などにより電子部品実装機（チップマウンタ）事業の競争力強化を図り、2008年度までに世界シェア20%獲得を目指していきます。

【新工場の概要】

- ・ 鉄骨2階建て
- ・ 所在地： 埼玉県熊谷市妻沼西一丁目6番、7番
- ・ 敷地面積： 32,500㎡
- ・ 延べ床面積： 17,500㎡
- ・ 竣工予定： 2008年2月
- ・ 総投資額： 約35億円



日立ハイテクインスツルメンツ 新工場（予想図）

お問い合わせ先

株式会社日立ハイテクインスツルメンツ 管理本部 担当：川田

TEL：0276-61-8200

報道機関お問い合わせ先

株式会社日立ハイテクノロジーズ

社長室 広報・IRグループ 担当：塩澤

TEL：03-3504-5637